



# TG-A09AB / TG-S09AB 导热封胶 Silicone Potting Compound

REACH Compliant RoHS Compliant

## 产品特性 Features

- 优异导热性能  
Good thermal conductivity
- 固化后保护电子元件防止受外界环境影响  
Protect electronic components after cured
- 一比一比例混合  
A:B=1:1
- 室温或加热熟化  
Cures at room temperature or with heat

## 产品应用端 Applications

电子元件 Electronic Components - 5G, Aerospace, AI, AIoT, AR/VR/MR/XR, Automotive, Consumer Devices, Datacom, Electric Vehicle, Electronic Products, Energy Storage, Industrial, Lighting Equipment, Medical, Military, Netcom, Panel, Power Electronics, Robot, Servers, Smart Home, Telecom, etc.

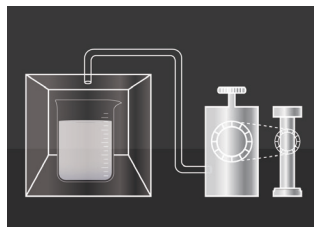
## 保存方式 Storage

导热封胶其在未开封之状态，在室温 25°C 以下可保存 12 个月。  
Silicone Potting Compound has a shelf-life of 12 months from the date of manufacture, as indicated by the lot number, when stored in the original, should be unopened container at or below 25°C.

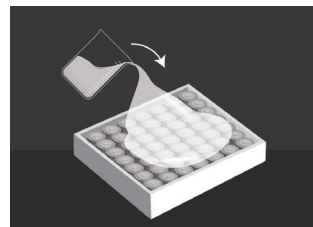
## 操作说明 Operation Manual



① Mix component A and B.



② Vacuum out air.

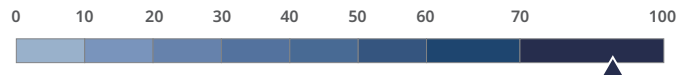
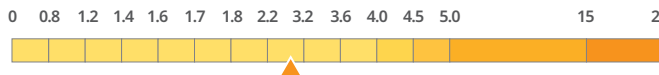


③ Pour potting compound.

## 产品物性 Properties

导热系数 Thermal Conductivity : 2.8 W/m·K

硬度 Hardness : 90 (Shore OO)



Properties	Unit	TG-A09AB / TG-S09AB	Tolerance	Test Method
导热系数 Thermal Conductivity	W/m·K	2.8	±10%	ASTM D5470 Modified
颜色 Color	-	灰 Gray (混合 Mix)	-	-
耐电压 Dielectric Breakdown Voltage	kV/mm	≥11	-	ASTM D149
体积阻抗 Volume Resistivity	Ohm·m	≥10 <sup>12</sup>	-	ASTMD257
密度 Density	g/cm <sup>3</sup>	2.52	±5%	ASTM D792
操作温度 Operating Temperature	°C	-50~+150	-	-
抗拉强度 Tensile Strength @3.0mm	kgf/cm <sup>2</sup>	230	-	ASTM D412
延展率 Elongation	%	55	-	ASTM D412
黏度 Viscosity	Pa·s	10~50	-	Brookfield Viscometer
重量损失 Weight Loss	%	<1	-	By T-Global
固化时间 Curing Time @25° C	hr	6	±10%	-
固化时间 Curing Time @50° C	hr	0.6	±10%	-
固化时间 Curing Time @80° C	hr	0.08	±10%	-
标准规格 Standard Package	-	罐装 Pot	-	-
硬度 Hardness	Shore OO	90	±10	-
混合比例 Mixing Ratio	gram	1:1	-	-

▶ A剂与B剂皆为混合材料，因密度不同会造成沉淀分层，属正常现象，使用前请用扁平刮刀或是其他不锈钢工具，分别均匀搅拌两剂再混和，以获得最好的导热效果。  
Component A & Component B are mixed material. It is normal to cause precipitation and stratification due to different density.  
Well mixed component A before use by a flat spatula or other stainless tools to achieve the ideal thermal conductivity.

## 高柏科技 T-Global Technonology Co., Ltd.

桃园市桃园区大仁路 50 巷 33 号 No.33, Ln.50, Daren Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330058, Taiwan  
T +886-3-361-8899 E service@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version20  
20250325



注意：本技术数据表内的资讯是根据高柏团队的研究与测试得出的最佳数据。本技术数据表中列出的值仅代表典型值，并非对每一批生产的物料都进行测试。  
所有规格如有变更，恕不另行通知；无影响产品功能之保护膜及离型纸，如非特殊要求，皆依高柏默认为准。由于各种可能的使用条件超出了我们的控制范围，因此我们提出的所有建议均不构成保证或责任，用户应自行进行测试，以确定我们的产品在任何特定情况下的适用性。本产品的销售没有任何明示或暗示的说明，表示其适用于特定目的或其他用途的保证，但本产品应依据高柏与您确认的发票、报价、或订单，提供最标准的产品质量。我们不承担使用者如何延伸或改变此技术数据表中的资讯，使用者应承担所有风险。此外，本技术数据表中的资讯不包含任何内容解释与涉及产品材料的现有用途、未来专利冲突、工艺制造，与使用产品的建议。